





Title of Change:	Change in Device Marking Font Size and Location for D2PAK Package in ON Seremban.	
Effective date:	30 July 2019	
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Zahir.Zul@onsemi.com>	
Type of notification:	This Product Bulletin is for notification purposes only. ON Semiconductor will proceed with implementation of this change upon publication of this Product Bulletin.	
Change Category:	<input type="checkbox"/> Wafer Fab <input type="checkbox"/> Assembly Change <input type="checkbox"/> Test Change <input checked="" type="checkbox"/> Other <u>Device Marking</u>	
Change Sub-Category(s):	<input type="checkbox"/> Manufacturing Site Addition <input type="checkbox"/> Material Change <input type="checkbox"/> Datasheet/Product Doc change <input type="checkbox"/> Manufacturing Site Transfer <input type="checkbox"/> Product specific change <input checked="" type="checkbox"/> Shipping/Packaging/Marking <input type="checkbox"/> Manufacturing Process Change <input type="checkbox"/> Other: _____	
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: ON Seremban, Malaysia	External Foundry/Subcon Sites: None
Description and Purpose:		
This notification is to inform customers on the changes of marking size and marking region below mold logo. However, ON logo and device marking arrangement on product still maintain as per ON Spec. The changes are for D2PAK package in ON Seremban.		
	Before Change Description	After Change Description
Marking	Marking height 57mm	Marking height 50mm Marking below mold logo
Example of marking		
There is no material change as a result of this change.		

**List of Affected Parts:**

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

BUB323ZG	MBRB2545CTT4G	MJB5742T4G	NTSB20100CTG
BUB323ZT4G	MBRB3030CTG	MTB50P03HDLT4G	NTSB20100CTT4G
MBRB1045G	MBRB3030CTLG	MURB1620CTG	NTSB20120CTG
MBRB1045T4G	MBRB3030CTT4G	MURB1620CTRG	NTSB20120CTT4G
MBRB1545CTG	MBRB30H60CTT4G	MURB1620CTRT4G	NTSB20U100CTG
MBRB1545CTT4G	MBRB40250TG	MURB1620CTT4G	NTSB20U100CTT4G
MBRB1645T4G	MBRB40250TT4G	MURB1660CTG	NTSB30100CTG
MBRB20100CTG	MBRB4030G	MURB1660CTT4G	NTSB30100CTT4G
MBRB20100CTT4G	MBRB4030T4G	MURHB840CTG	NTSB30120CTG
MBRB20200CTG	MBRB41H100CTT4G	MURHB840CTT4G	NTSB30120CTT4G
MBRB20200CTT4G	MBRB60H100CTT4G	MURHB860CTT4G	NTSB30U100CTG
MBRB2060CTG	MBRB8H100T4G	NTB25P06T4G	NTSB30U100CTT4G
MBRB2060CTT4G	MJB41CG	NTB35N15T4G	NTSB40100CTG
MBRB20H100CTT4G	MJB41CT4G	NTB45N06LT4G	NTSB40100CTT4G
MBRB2515LG	MJB42CT4G	NTB45N06T4G	NTSB40120CTG
MBRB2515LT4G	MJB44H11G	NTB5405NT4G	NTSB40120CTT4G
MBRB2535CTLG	MJB44H11T4G	NTB5605PT4G	NTSB40200CTG
MBRB2535CTLT4G	MJB45H11G	NTB60N06T4G	NTSB40200CTT4G
MBRB2545CTG	MJB45H11T4G	NTB6410ANT4G	NTSB60100CTG
		NTB6413ANT4G	NTSB60100CTT4G

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.







注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



製品速報

文書番号: PB22792X

発行日: 30 July 2019

変更件名:	オン セレンバンでの D2PAK パッケージの製品マーキングフォントサイズおよび位置の変更。										
発効日:	30 July 2019										
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Zahir.Zul@onsemi.com> にお問い合わせください。										
通知種別:	本製品速報は通知目的のみのものです。オン・セミコンダクターは本製品速報の発行により本変更を実行します。										
変更カテゴリ:	<input type="checkbox"/> ウェハファブの変更 <input type="checkbox"/> アセンブリの変更 <input type="checkbox"/> 試験の変更 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <u>Device Marking</u>										
変更サブカテゴリ:	<input type="checkbox"/> 製造拠点の追加 <input type="checkbox"/> 材料の変更 <input type="checkbox"/> データシート/製品資料の変更 <input type="checkbox"/> 製造拠点の移転 <input type="checkbox"/> 製品仕様の変更 <input checked="" type="checkbox"/> 出荷/パッケージング/表記 <input type="checkbox"/> 製造プロセスの変更 <input type="checkbox"/> その他: _____										
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: ON Seremban, Malaysia	外部製造工場 / 下請業者拠点: なし									
説明および目的:	<p>本通知は、マーキングサイズおよびモールドロゴ下のマーキング領域の変更をお知らせするものです。しかしながら、製品のオンロゴおよび製品マーキング配置は依然としてオン仕様を維持します。変更はオン セレンバンでの D2PAK パッケージに適用されます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前の表記</th> <th>変更後の表記</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>マーキング</td> <td>マーキング高さ 57 mm</td> <td>マーキング高さ 50 mm モールドロゴ下のマーキング</td> </tr> <tr> <td>マーキングの例</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>今回の変更に伴う材料の変更はありません。</p>			変更前の表記	変更後の表記	マーキング	マーキング高さ 57 mm	マーキング高さ 50 mm モールドロゴ下のマーキング	マーキングの例		
	変更前の表記	変更後の表記									
マーキング	マーキング高さ 57 mm	マーキング高さ 50 mm モールドロゴ下のマーキング									
マーキングの例											



影響を受ける部品の一覧:

注: 標準の部品番号(既製品)のみが部品一覧に記載されます。本 PCN に影響を受けるカスタム 部品は、PCN メールのお客様の特定の PCN の付属文書、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

BUB323ZG	MBRB2545CTT4G	MJB5742T4G	NTSB20100CTG
BUB323ZT4G	MBRB3030CTG	MTB50P03HDLT4G	NTSB20100CTT4G
MBRB1045G	MBRB3030CTLG	MURB1620CTG	NTSB20120CTG
MBRB1045T4G	MBRB3030CTT4G	MURB1620CTRG	NTSB20120CTT4G
MBRB1545CTG	MBRB30H60CTT4G	MURB1620CTRT4G	NTSB20U100CTG
MBRB1545CTT4G	MBRB40250TG	MURB1620CTT4G	NTSB20U100CTT4G
MBRB1645T4G	MBRB40250TT4G	MURB1660CTG	NTSB30100CTG
MBRB20100CTG	MBRB4030G	MURB1660CTT4G	NTSB30100CTT4G
MBRB20100CTT4G	MBRB4030T4G	MURHB840CTG	NTSB30120CTG
MBRB20200CTG	MBRB41H100CTT4G	MURHB840CTT4G	NTSB30120CTT4G
MBRB20200CTT4G	MBRB60H100CTT4G	MURHB860CTT4G	NTSB30U100CTG
MBRB2060CTG	MBRB8H100T4G	NTB25P06T4G	NTSB30U100CTT4G
MBRB2060CTT4G	MJB41CG	NTB35N15T4G	NTSB40100CTG
MBRB20H100CTT4G	MJB41CT4G	NTB45N06LT4G	NTSB40100CTT4G
MBRB2515LG	MJB42CT4G	NTB45N06T4G	NTSB40120CTG
MBRB2515LT4G	MJB44H11G	NTB5405NT4G	NTSB40120CTT4G
MBRB2535CTLG	MJB44H11T4G	NTB5605PT4G	NTSB40200CTG
MBRB2535CTLT4G	MJB45H11G	NTB60N06T4G	NTSB40200CTT4G
MBRB2545CTG	MJB45H11T4G	NTB6410ANT4G	NTSB60100CTG
		NTB6413ANT4G	NTSB60100CTT4G